

2015-2020年中国IC载板 市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2015-2020年中国IC载板市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1412/E64775AP14.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7200元 纸介+电子7500元

【出版日期】2014-12-04

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2015-2020年中国IC载板市场分析与投资前景研究报告》共五章。介绍了IC载板行业相关概述、中国IC载板产业运行环境、分析了中国IC载板行业的现状、中国IC载板行业竞争格局、对中国IC载板行业做了重点企业经营状况分析及中国IC载板产业发展前景与投资预测。您若想对IC载板产业有个系统的了解或者想投资IC载板行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

PCB行业可分硬板（Rigid PCB）、软板（FPCB）、载板（Substrate）三大类。IC载板行业在2012和2013年两年连续下滑，根源在两方面：一是因为PC出货量下降，而CPU用载板是IC载板的主要类型，是单价（ASP）最高的载板；二是韩国企业为压制日本和台湾IC载板厂家的发展，大幅度降价，尤其是三星旗下的三星电机（SEMCO）大幅度降价近30%。这导致2013年全球IC载板行业市场规模下跌10.3%，至75.68亿美元。不过苦尽甘来，预计2014和2015年IC载板行业将迎来增长。

2014年增长的动力有几方面。首先是联发科的8核芯片MT6592采用FC-CSP封装，该芯片在2013年10月推出，预计2014年出货量会大增。随着联发科进入28nm时代，联发科会全面采用FC-CSP封装，接下来中国大陆的展讯也会采用。其次是LTE 4G网络开始兴建，BASESTATION 芯片需要IC载板。

其三，是可穿戴设备（wearable devices）大量进入市场，这会刺激SiP模块封装，也需要IC载板。其四是手机追求超薄，就需要芯片具备良好的散热，FC-CSP封装在散热和厚度方面优势明显，未来手机的主要芯片都会是FC-CSP封装或SiP模块封装，包括电源管理和存储器。

其五，PC行业在2014年复苏。平板电脑在2014年高增长不再来，甚至会下滑，消费者意识到平板电脑只能做玩具，完全无法和PC比性能，PC行业将复苏。最后三星电机（SEMCO）不再杀价竞争，因为苹果下一代处理器A8确定会由台湾TSMC代工，而非三星电子代工。三星电机（SEMCO）即便杀价，也不可能让台湾TSMC给予其订单。

预计2014年全球IC载板行业市场规模增长9.8%，2015年会加速增长，增幅达11.6%。

IC载板行业可以分为日韩台三大阵营。日本企业是IC载板的开创者，技术实力最强，掌握利润最丰厚的CPU载板。韩国和台湾企业则依靠产业链配合，韩国拥有全球70%左右的内存产能，三星一直为苹果代工处理器，三星也能够生产部分手机芯片。

台湾企业则在产业链上更强大，台湾拥有全球65%的晶圆代工产能，80%的手机高级芯片由台湾TSMC或UMC代工，这些代工的利润率远高于传统电子产品的利润率，毛利率在50%以上。以联发科的MT6592为例，代工由TSMC或UMC完成，封装由ASE和SPIL完成，载板由景

硕提供，测试由KYECC完成，这些厂家都在一个厂区内，效率极高。

大陆企业在产业链完全没有任何优势，缺乏晶圆代工厂家和封装厂家支持，落后台湾数年乃至十几年。即便有海思和展讯这样出货量不低的大陆企业，台湾厂家仍然占据供应链的话语权。

报告目录：

第一章、全球半导体产业

1.1、全球半导体产业概况

1.2、IC封装概况

1.3、IC封测产业概况

第二章、IC载板简介

2.1、IC载板简介

2.2、FLIP CHIP IC 载板

2.3、IC载板趋势

第三章、IC载板市场与产业

3.1、IC载板市场

3.2、手机市场

3.3、WLCSP市场

3.4、PC市场

3.5、平板电脑市场

3.6、FPGA与CPLD市场

3.7、IC载板产业

3.8、晶圆代工FOUNDRY市场规模

3.9、晶圆代工行业竞争分析

第四章、IC载板厂家研究

4.1、欣兴

4.2、IBIDEN

4.3、大德电子

- 4.4、SIMMTECH
- 4.5、LG INNOTEK
- 4.6、SEMCO
- 4.7、南亚电路板
- 4.8、景硕KINSUS
- 4.9、SHINKO
- 4.10、KYOCERA SLC
- 4.11、AT&S

第五章、IC载板封装厂家研究

- 5.1、日月光
- 5.2、AMKOR
- 5.3、矽品精密
- 5.4、星科金朋
- 5.5、三菱瓦斯化学

图表目录：

- 2015-2020年全球半导体产业季度收入
- 2014-2017年全球半导体产业年度收入
- 2012-2017年全球半导体市场产品分布
- 2012-2017年各种半导体产品市场规模增幅
- 主要电子产品使用IC的封装类型
- 2012-2017年全球IC Packaging and Test市场规模
- 2012-2017年全球Outsourcing IC Packaging and Test市场规模
- 2012-2017年全球IC Packaging 市场规模
- 2012-2017年全球IC Test市场规模
- 2015-2020年台湾封测产业收入
- 2013年全球前10大封装企业收入
- 2014-2016年IC载板市场规模
- IC载板具体应用产品
- 2011-2016 IC载板 by node
- 2013-2015年全球手机出货量
- Worldwide Smartphone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units)

Worldwide Smartphone Sales to End Users by Operating System in 2013 (Thousands of Units)

Worldwide Mobile Phone Sales to End Users by Vendor in 2013 (Thousands of Units)

2010-2016年WLCSP封装市场规模

2010-2016年WLCSP出货量下游应用分布

2013-2015年全球PC用CPU与Discrete GPU 出货量

2014-2016年全球平板电脑出货量

2013年平板电脑主要品牌市场占有率

2012、2013年全球平板电脑制造厂家产量

2014年FPGA、CPLD市场下游分布与地域分布

2014-2016年主要FPGA厂家市场占有率

2010-2014年主要IC载板厂家收入

2014-2017年全球Foundry市场规模

2012-2017 Foundry Revenue of Advanced Nodes

2012-2018 Global Foundry capacity by node

2012-2018 Global Foundry revenue by node

Global ranking by foundry

2013-2014年欣兴收入与毛利率

2015-2020年欣兴收入与营业利润率

2012年1季度-2014年1季度欣兴季度收入与毛利率

2010-2014年欣兴销售额技术分布

2010-2014年欣兴收下游应用分布

2010-2014欣兴产能Capacity

2004-2013年欣兴CAPEX

欣兴历年合并

2012年2季度-2014年1季度IBIDEN季度收入业务分布

2012年2季度-2014年1季度IBIDEN季度营业利润业务分布

2010-2015财年ibiden电子事业部收入产品分布

2010-2015财年ibiden CAPEX与depreciation

SIMM TECH组织结构

2015-2020年SIMMTECH资产负债表

2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度收入产品分布

2012-2015年SIMMTECH收入产品分布

2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度毛利率与运营利润率

2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度出货量

2012-2015年SIMMTECH出货量

2013年1季度-2014年4季度SIMMTECH季度产能利用率

2012-2015年SIMMTECH产能利用率

2013-2014年SIMMTECH收入by application

2012-2014年SIMMTECH Substrate收入by application

2013-2014年LG INNOTEK收入与运营利润率

2013-2015年SEMCO IC Substrate sales by technology

2013-2015年SEMCO IC Substrate operatio profit by technology

南亚电路板组织结构

2013-2014年南亚电路板收入与毛利率

2015-2020年南亚电路板收入与营业利润率

2012年5月-2014年5月南亚电路板每月收入与增幅

2013-2014年景硕收入与毛利率

2015-2020年景硕收入与营业利润率

2012年5月-2014年5月景硕每月收入与增幅

2013-2014年景硕收入产品分布

2013年景硕收入下游应用分布

Q1/2014景硕收入BY Applications

2013\2014 KINSUS客户分布

2013-2015财年Shinko收入与净利润

2010-2014财年Shinko收入业务分布

2013-2014财年 AT&S与EBITDA率

AT&S重庆substrate厂 ramp

FY2014 AT&S收入地域分布

FY2014 AT&S资产负债表

2012-2014年日月光收入与营业利润率

2012年5月-2014年5月日月光月度收入

2014-2016年ASE收入业务分布

2013年1季度-2014年1季度ASE封装部门收入与毛利率

2013年1季度-2014年1季度ASE封装部门收入类型分布

2013年1季度-2014年1季度ASE材料部门收入与毛利率

2013年1季度-2014年1季度ASE EMS收入与毛利率

2013年1季度-2014年1季度ASE EMS收入breakdown

2014年1季度ASE收入下游应用

2014-2016年Amkor收入封装类型分布

矽品精密工业组织结构

2012年5月-2014年5月SPIL月度收入

2012年1季度-2014年1季度SPIL季度收入、毛利率与营业利润率

2014-2015年矽品收入地域分布

2014-2015年矽品收入下游应用分布

2014-2015年矽品收入业务分布

矽品2006-2014年产能统计

三菱瓦斯化学Organization Chart

2014-2015财年MGC收入与营业利润

2014-2015财年MGC收入by segment

2014-2015财年MGC operation income by segment

2013-2014年全球3G/4G手机出货量地域分布

欣兴组织结构

2014-2015财年IBIDEN收入与运营利润率

2014-2015财年IBIDEN收入业务分布

2014-2015年大德电子收入与运营利润率

2015-2020年大德电子收入by business

2013-2014年SIMMTECH收入与运营利润率

2015-2020年SIMMTECH收入、毛利率与净利率

SIMMTECH厂区

2011年1季度-2014年1季度LG INNOTEK收入与运营利润率

2011-2014年LG INNOTEK 收入业务分布

2011-2013年LG INNOTEK 运营利润业务分布

2013-2014年SEMCO收入部门分布

2012-2014年SEMCO营业利润部门分布

2013年1季度-2014年4季度SEMCO ACI事业部收入与运营利润率

南亚电路板产能与全球分布

日月光组织结构

2013-2014年日月光收入与毛利率

2014-2015年Amkor收入与毛利率、运营利润率

2013-2014年矽品收入、毛利率、运营利润率

2013-2014年星科金朋收入与毛利率

2014-2015年星科金朋收入封装类型分布

2014-2015年星科金朋收入下游应用分布

2014-2015年星科金朋收入 地域分布

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自 国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1412/E64775AP14.html>